

Cu核ボールで、3D実装と狭ピッチ実装を容易に

Cu core ball facilitate 3D packaging and narrow-pitch mounting

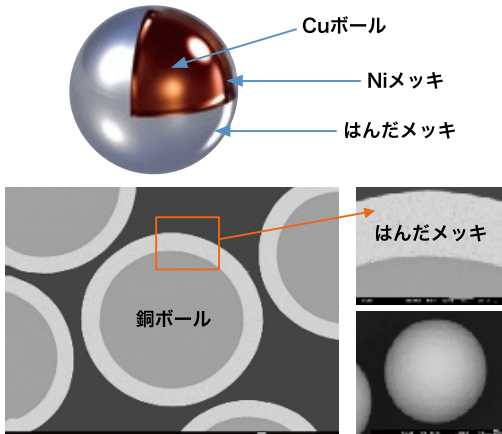
特長

- 空間を確保し、容易に信頼性の高い部品内蔵構造を実現
- 従来設備で、Cuピラーと同様な狭ピッチ実装が可能
- 高放熱性とエレクトロマイグレーション対策をお約束

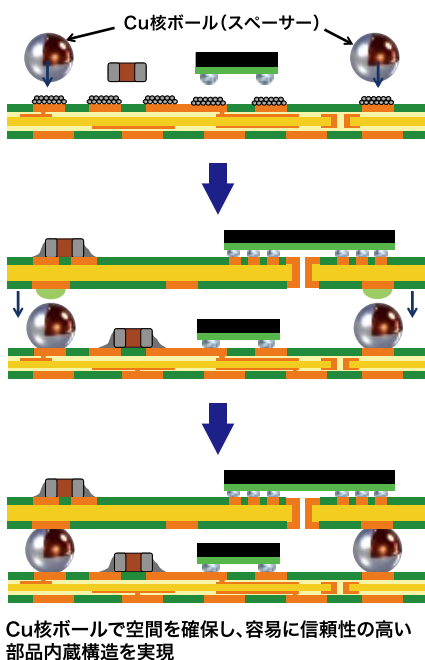


仕様

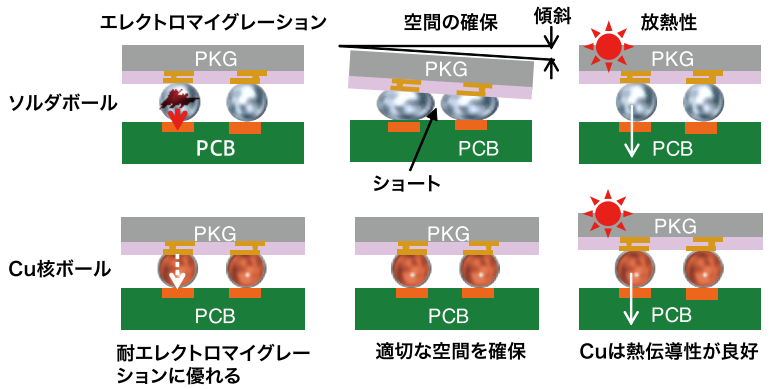
- Cuを核とする多層構造で空間を確保



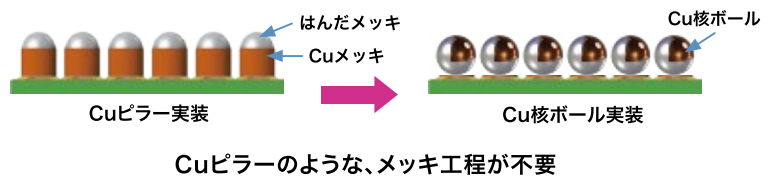
- Cu核ボールで3D実装を容易に



- 特徴



- 従来設備で、短絡リスクのない狭ピッチ実装が可能



- 落下試験と温度サイクル試験

